

<<SMT技术基础与设备>>

图书基本信息

书名：<<SMT技术基础与设备>>

13位ISBN编号：9787121035616

10位ISBN编号：7121035618

出版时间：2007-1

出版时间：电子

作者：黄永定主编

页数：236

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<SMT技术基础与设备>>

内容概要

本书系统论述了表面组装元器件，表面组装材料，表面组装工艺，表面组装质量检测，表面组装设备原理及应用等SMT基础内容。

编写中特别强调了生产现场的技能性指导，针对SMT产品制造业的技术发展及岗位需求，详细介绍了SMT的锡膏印刷、贴片、焊接、清洗等基本技能。

为解决学校实训条件不足的问题和增强学生的感性认识，书中配置了大量的实物图片。本书语言叙述浅显易懂，内容翔实，可作为中等职业学校SMT专业或电子制造工艺专业方向的教材；也可作为其他相关专业的辅助教材或SMT企业工人的自学参考资料。

本书还配有电子教学参考资料包（包括教学指南、电子教案和习题答案），详见前言。

<<SMT技术基础与设备>>

书籍目录

第1章 SMT与SMT工艺 1.1 SMT的发展 1.2 表面组装技术的优越性 1.3 表面组装技术的组成 1.4 表面组装工艺 思考与练习题第2章 表面组装元器件 2.1 表面组装元器件的特点和种类 2.2 表面组装电阻器 2.3 表面组装电容器 2.4 表面组装电感器 2.5 其他表面组装元件 2.6 表面组装分立器件 2.7 表面组装集成电路 2.8 表面组装元器件的包装方式与使用要求 2.9 集成电路封装的发展 思考与练习题第3章 表面组装印制板的设计与制造 3.1 SMB的特点与基板材料 3.2 表面组装印制板的设计 3.3 SMB的具体设计要求 3.4 印制电路板的制造 思考与练习题第4章 焊锡膏及印刷技术 4.1 焊锡膏 4.2 焊锡膏印刷的漏印模板 4.3 焊锡膏印刷机 4.4 焊锡膏的印刷工艺流程 4.5 印刷机的工艺参数 思考与练习题第5章 贴装胶与涂布技术 5.1 贴装胶的分类 5.2 贴装胶的应用 5.3 贴装胶涂布工艺 5.4 贴装胶涂布设备简介 思考与练习题第6章 SMT贴片工艺和贴片机 6.1 自动贴片机的结构与技术指标 6.2 贴片机的工作方式与贴片质量要求 6.3 手工贴装SMT元器件 思考与练习题第7章 焊接工艺原理与波峰焊 7.1 电子产品焊接工艺原理和特点 7.2 表面组装的自动焊接技术 7.3 波峰焊与波峰焊机 7.4 几种新型波峰焊机 7.5 波峰焊质量缺陷及解决办法 思考与练习题第8章 再流焊与再流焊设备 8.1 再流焊工作原理 8.2 再流焊炉的主要结构和工作方式 8.3 再流焊种类及加热方法 8.4 通孔再流焊工艺 8.5 各种再流焊设备及工艺性能比较第9章 SMA在线测试、返修及手工焊接实训第10章 清洗工艺与清洗剂第11章 SMT的静电防护技术第12章 SMT产品质量控制与管理第13章 SMT的无铅工艺制程附录 本书专业英语词汇参考文献

<<SMT技术基础与设备>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>